

2023 반도체산업 온라인 채용 박람회(참가 인재) 신청 방법

1 행사 개요

- 행사명 : 2023 반도체산업 온라인 채용 박람회
- 목 적 : 중견·중소기업의 원활한 신입 인력 수급과 채용 증진
- 일 시 : 2023. 10. 24(화)~25(수) (2일간), 10:00 ~ 17:00
(9:30~10:00 : 기업별 면접 준비, 10:00~17:00 : 면접진행)
- 방 법 : Zoom을 활용한 온라인 면접 진행
* 단, 오프라인 면접 기업은 개별적으로 서류합격자에 한해 안내
- 기 타 : 경기도 거주민(주민등록상)은 면접 진행시 “경기도 청년면접수당” 신청 가능(협회에서 별도 서류 송부 예정/요청자에 한함)
* 면접 종료 후 3일 이내 담당자에게 요청(해당 기간 이후 요청자는 발급불가)

2 행사 운영(안)

- 진행일정 및 절차

일 정	세부 내용	비 고
9/18(월) ~ 10/13(금)	기업 및 학생 신청 접수	홈페이지를 통한 개별 지원
10/16(월) ~ 10/18(수)	기업 및 학생 면접 수요조사 및 면접자 확정	면접확정자 개별 통보
10/19(목) ~ 10/20(금)	면접스케줄 조정 및 안내	온라인 면접시간 안내
10/24(화) ~ 10/25(수)	Zoom 온라인 면접(비대면)	학생 개별 접속

* 상기 일정은 상황에 따라 조정될 수 있음

- 면접 사전 매칭
 - 채용 연계율을 높이기 위해 상호간 선호도를 조사를 통한 현장면접 지원
 - 잡페어 신청홈페이지를 통해 면접 희망 기업 선택 및 지원

< 잡페어 면접 진행 관련 참가자 안내사항 >

- 본 잡페어 행사는 기업-학생 간 유효한 인터뷰 진행을 위해 사전에 확정된 면접스케줄에 따라 진행되며, 행사 당일 접수는 진행하지 않습니다. (사전접수마감)
- 면접 매칭 진행 절차
 - 1차 매칭 조사
 - 선택 기업수 제한은 없으나, 입사에 관심있는 기업 중심으로 지원바랍니다.
 - 첨부된 참여 기업 정보(참가목적, 모집분야, 참여일 등) 확인 후 지원바랍니다.
 - 2차 매칭 조사
 - 본인과 면접을 희망하는 기업리스트 중 입사에 관심이 있는 기업에 지원바랍니다.
 - 2차 희망조사까지 매칭되는 기업이 없을 시 면접 참여가 불가할 수 있습니다.
 - 상호 매칭이 완료되면 면접스케줄을 확정하며, 사전 안내드릴 예정입니다.
- 온라인 면접 시 면접에 준하는 복장(정장 또는 단정한 복장)으로 참석이 필요
 - 채용 연계 기업 : 온라인 면접에서 불/합격여부를 판단하지 않으나, 1차 면접 통과자에 한해 기업의 채용 프로세스로 이관하여 2차 면접 진행하게 됩니다.
 - 면접 결과가 우수할 경우, 개별 연락을 통해 면접자의 참여 의사 확인이 이루어지며, 원하는 분에 한해 기업의 채용프로세스로 이관됩니다.
 - 기업홍보 및 공채지원 독려 기업 : 채용 연계 기업과 동일한 절차(사전매칭)에 의해 면담자를 선정하며, 채용 연계 기업과 동일하게 기업의 인사담당자가 참여합니다.
 - 현재 채용 계획이 있는 기업이 아니기 때문에 케쥬얼한 분위기로 진행되나, 추후 협회를 통해 우수학생에 대해 추가 면담을 요청하는 사례도 빈번하므로 진지한 자세로 임해주시기 바랍니다.
- 행사와 관련된 안내는 신청 홈페이지에 기재된 연락처(이메일/휴대전화)로 진행됩니다.
- 문의처 : 한국반도체산업협회 정은비 PM (02-570-5233, jeb119@ksia.or.kr)

2023 반도체산업 온라인 채용 박람회(참가 인재) 신청 방법

1. <http://hrd.ksia.or.kr/> 에 접속한다.
2. 홈페이지 우측 상단의 로그인(Login) 클릭



1) 신규 회원 : 회원가입 필요

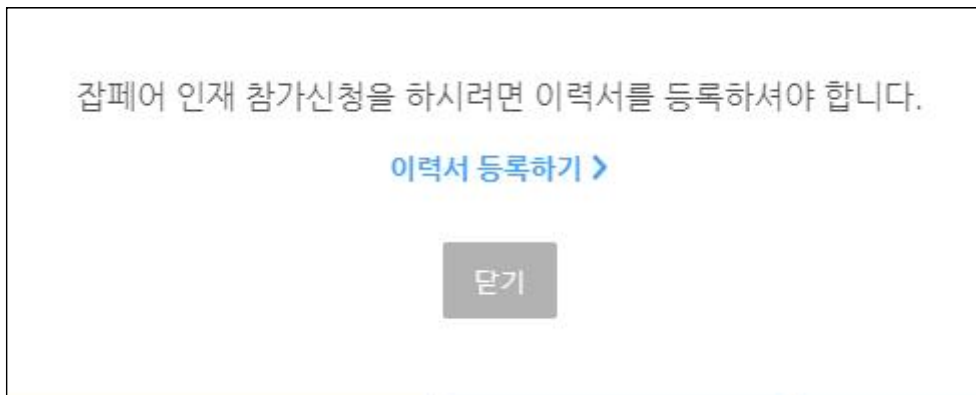
- 이메일/비밀번호/이름/휴대폰 입력 후 가입한 휴대폰으로 추가 인증(인증번호) 진행
- 기존에 가입한 이력이 있는 휴대폰번호로는 신규 가입 불가함

2) 기존 회원 : 이메일/비밀번호 입력 후 로그인 클릭

- 전년도 참가학생은 전년도 가입당시 아이디(이메일) 비밀번호 사용/비밀번호 분실 시 비밀번호 찾기로 확인 가능)

3. 이력서 등록하기

- 1) 우측상단 JobFair 클릭, 하단의 인재 참가신청 클릭
 - 이력서 등록하기 클릭, 이력서 등록



2) 이력서 작성

- 현재 구직상태 필히 체크
- 이력서 제목 입력 (본인을 PR할 수 있는 한줄 제목 작성)
- 관심 카테고리 체크 (중복선택 가능)

관심 카테고리 ● 중복선택 가능 * 필수 입력 정보입니다.

반도체 소자	반도체 공정 관리 (Process Integrator) 반도체 소자 설계 및 개발 (Technology Development) 반도체소자 모델링 (SPICE modeling, PDK) 반도체 제품 마케팅, 기획 반도체 불량분석(Failure Analysis), 품질관리 (신뢰성, QA) 반도체 시뮬레이션 개발(TCAD, SPICE 등)
반도체 설계1 (디지털)	디지털 회로설계 Digital IP 설계 설계회로 시뮬레이션 검증 실시간검증 (FPGA) 회로합성 및 DFT설계
반도체 설계2 (아날로그)	Data Converter IP Interface IP Clock Domain IP Design Kit Manage 성능 검증
반도체 설계3 (레이아웃)	자동배치백선 (Auto P&R) Full Custom 레이아웃설계
반도체 전공정	통합공정 단위공정 (제조공정) 공정설비 불량분석 및 계측
반도체 테스트	Test 프로그램 개발 Test 설비
반도체 패키징	회로설계 (패키지설계) 패키징 장비 기술 패키징 공정 기술 품질 분석 기구설계 소프트웨어설계
반도체장비/부분품1 (기구설계)	기구설계
반도체장비/부분품2 (SW설계)	SW설계
반도체장비/부분품3 (전장설계)	전장설계

3) 인적사항 등록

- 사진(명함) 등 개인정보 정확하게 입력
- 추가인적사항 공개여부 체크 후 입력

4) 학력사항

- * 최종학력 기준으로 탭을 선택하여 작성 ex) 학사 졸업(예정)자 : 학사졸업 선택
- 고등학교 전공(학과)는 특정 학과가 없을 경우 문과,이과로 작성

5) 이수과목

- 공개로 체크하는 것이 유리(기업 입장에서 관심인재 검색이 용이함)
- 관련 교과목 이수자는 정확한 명칭과 일부 상이하더라도 최대한 유사한 과목으로 체크 바람(직전학기 기준 이수과목 모두 체크 필요)
- 이수과목 증빙서류 필수 업로드(해당 증빙이 없을시 무효화 처리)

6) 어학성적/회화능력/자격증/수상내역(공모전)/교육연수/대외활동/경력사항 등 양식에 맞춰 추가 이력 사항 작성

* 해당 사항이 있는 항목에 한해 선택 작성 가능

- 해당 사항이 있을 경우 “공개”로 체크하는 것이 유리

7) 자기소개서는 대표 자기소개서로 특정 기업명을 언급하지 않고 작성(개별 기업별 지원시 자기소개서 요약본 별도로 작성해야 함)

8) 이력서 작성 완료 클릭

- 이력서 등록후 반도체협회 관리자 승인처리 필요

위의 사항이 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

이력서 작성 완료

4. JobFair 참가신청하기

- 우측상단 JobFair 클릭, 하단의 인재 참가신청 클릭하면 최종 참가신청 완료

인재정보관리시스템

사업소개 기업 홍보관 JobFair 반도체정보 My Page Logout

JobFair > 2023 반도체산업 온라인 채용 박람회

2023 반도체산업 온라인 채용 박람회

행사명 2023 반도체산업 온라인 채용 박람회

일시 2023-10-24(화) ~ 2023-10-25(수) 10:00 ~ 17:00

장소 Zoom 온라인 비대면

주최 한국반도체산업협회

·인재 참가신청 이력서 등록 신청을 한 후 관리자의 승인을 받은 회원에 한해 신청가능
·기업 참가신청 기업정보 등록 신청을 한 후 관리자의 승인을 받은 회원에 한해 신청가능

잡페어 신청안내 자세히보기 인재 참가신청 기업 참가신청